

ダイフレックス企業製品セミナー

超速硬化スプレーウレタン防水が建築デザインを変える

00200926
2単位

CPD認定プログラム

参加無料

日時 平成29年7月27日(木) 15:00~17:30 (受付 14:00~)

会場 グランフロント大阪 コンファレンスホールタワーB10階 大阪市北区大深町3-1

定員 80名

時代の変遷により、今やウレタン防水が防水材料のトップシェアとなりました。

中でも、超速硬化スプレーウレタン防水が近年伸びており、納まりの優位性や様々な用途に対応する高機能な製品開発により新築物件に採用されるケースが増えてきております。

今回は、弊社防水工法を数多くの物件においてご採用いただいているプロフェッショナルをお呼びして、超速硬化スプレーウレタン防水を採用する際のポイントをご紹介します。

講師紹介 須部 恭浩 (すべ やすひろ)

1995年 明治大学理工学部建築学科卒業
1995年 三菱地所株式会社
2001年 株式会社三菱地所設計
2003年 株式会社三菱地所設計 上海事務所 首席代表
2013年 株式会社三菱地所設計
東京建築設計6部 兼 海外設計部



アクセス

- ・JR大阪駅(アトリウム広場)より徒歩約4分
- ・地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩約4分
- ・阪急電鉄「梅田駅」より徒歩約4分

【順路】

- ①JR中央北口アトリウム広場 出口
- ②2F連絡デッキより北館へ直進
- ③2F Tower B Office入口奥エレベーターにて9Fへ
→専用エスカレーターにて10F



セミナースケジュール

会場：Room B05-B06

時間	予定
15:00~15:10	メーカー挨拶
15:10~16:00	第一部 基調講演 (株)三菱地所設計 須部 恭浩 様 ～超速硬化スプレーウレタン防水が 建築デザインを変える～
16:00~16:10	休憩
16:10~17:30	第二部 メーカー講演 (株)ダイフレックス ～超速硬化スプレーウレタン防水の 用途展開について～

※スケジュールやプログラムは、当日の進行状況により変更される場合がありますので、予めご了承ください。

セミナー参加のお申し込みは、メール(oosaka@dyflex.co.jp)

または裏面FAXの申込書でお申し込みください。

※メールの場合は、必ず裏面記載情報をご入力ください。

ダイフレックス企業製品セミナー
超速硬化スプレーウレタン防水が建築デザインを変える

参加申込書

下記セミナーへの参加を申し込みます。

申込日 年 月 日

お申込の
プログラム

超速硬化スプレーウレタン防水が建築デザインを変える〔大阪会場〕
平成29年7月27日 15:00~17:30 (受付14:00~)
参加料：無料

社名：

住所：

電話：

FAX：

E-mail：

参加者氏名1：



参加者氏名2：



参加者氏名3：



参加者氏名4：



その他：

★建築CPD情報提供制度のID番号をご記入ください



定員になり次第、お申し込みを締め切らせていただきます。

お問合せ先 メール oosaka@dyflex.co.jp
(株)ダイフレックス大阪支店 北川宛
TEL 06-6292-0511 FAX 06-6292-0522